

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 2025年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度的定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。

一、2025 年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	264,923.17	212,145.26	24.88
营业利润	-73,761.12	-73,917.57	不适用
利润总额	-73,775.11	-73,764.25	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-73,775.55	-73,764.25	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-80,892.22	-76,255.09	不适用
基本每股收益（元）	-0.20	-0.21	不适用
加权平均净资产收益率	-7.05%	-8.32%	增加 1.27 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	2,068,309.43	1,742,196.67	18.72
归属于母公司的所	1,241,699.28	851,481.36	45.83

有者权益			
股本（万股）	403,780.00	350,000.00	15.37
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	3.08	2.43	26.41

注：1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2. 以上财务数据及指标未经审计，最终结果以公司 2025 年年度的定期报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况、财务状况

报告期内，公司营业收入为 264,923.17 万元，同比增幅为 24.88%；营业利润为-73,761.12 万元，利润总额为-73,775.11 万元，归属于母公司所有者的净利润为-73,775.55 万元，均与上年同期相比基本持平；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-80,892.22 万元，亏损同比扩大 6.08%。

报告期末，公司总资产 2,068,309.43 万元，较报告期初增长 18.72%；归属于母公司的所有者权益 1,241,699.28 万元，较报告期初增长 45.83%。

2、影响经营业绩的主要因素

根据国际半导体产业协会（SEMI）最新发布的硅片行业年终分析报告，2025 年全球硅片出货面积同比增长 5.8%，同期销售额同比下降 1.2%。虽然数据中心与人工智能等领域投资维持高位，先进制程细分市场的需求旺盛，但下游需求向硅片环节传导存在一定滞后性；另一方面，汽车、工业及消费电子等传统应用仍处于库存调整阶段，整体供需关系尚未显著改善；加之国内硅片厂扩产产能集中释放，12 英寸硅片竞争加剧，产品价格阶段性承压。

同时，受到客户产能释放节奏、半导体硅片产品认证周期等因素影响，公司产品结构尚需进一步优化；公司第二工厂正处于产能爬坡阶段，产能尚未完全释放，固定资产折旧等固定成本未能实现有效摊薄，规模效应暂未充分显现；加之公司为保障核心竞争力，持续维持较高强度的研发投入。多重因素共同导致报告期内公司仍存在业绩亏损。值得关注的是，公司经营性现金净流入保持为正，具备良好的可持续经营能力。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30% 以上的主要原因

公司本报告期末归属于母公司的所有者权益较报告期初增长 45.83%，主要系报告期内收到上市募集资金，股本及资本公积增加所致。

三、风险提示

本公告所载 2025 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司 2025 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2025 年年度定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日